

# 半导体热阻测试方法，冷热冲击试验报告

产品名称	半导体热阻测试方法，冷热冲击试验报告
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

半导体热阻测试方法，冷热冲击试验报告

测试成本与测试时间成正比，而测试时间取决于测试行为，包括低速的参数测试和高速的矢量测试（功能测试）。其中参数测试的时间与管脚的数目成比例，适量测试的时间依赖于矢量的数目和时钟频率。测试的成本主要是功能测试。

半导体测试贯穿设计、制造、封装、应用全过程。从初形成满足特定功能需求的芯片设计，经过晶圆制造、封装环节，在终形成合格产品前，需要检测产品是否符合各种规范。按生产流程分类。半导体测试可以按生产流程可以分为三类：验证测试、晶圆测试测试、封装检测。

（1）验证测试：又称实验室测试或特性测试，是在器件进入量产之前验证设计是否正确，需要进行功能测试和全面的AC/DC。特性测试确定器件工作参数的范围。通常测试坏情况，因为它比平均情况更容易评估，并且通过此类测试的器件将会在其他任何条件下工作。

（2）晶圆测试：每一块加工完成后的芯片都需要进行晶圆测试，

他没有特性测试全面，但必须判定芯片是否符合设计的质量和需  
求。测试矢量需要高的故障覆盖率，但不需要覆盖所有的功能和  
数据类型。晶圆测试主要考虑的是测试成本，需要测试  
时间小，只做通过/不通过的判决。